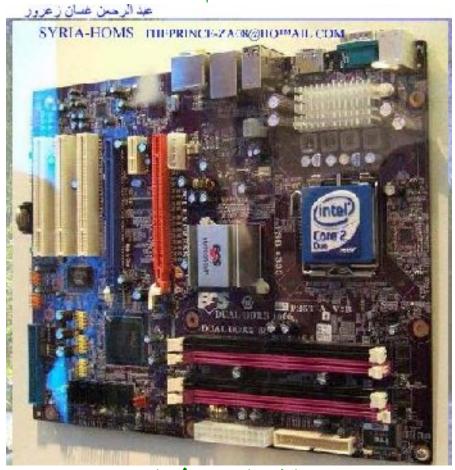
شرح مميزات الرام الجديد DDR3 بالتفصيل قبل كل شيئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



تحتوي الذاكرة (DDR3)على الكثير من المزايا التقتية وذلك بالمقارنة بوحدات الذاكرة السابقة. وبالنسبة لعامل أستهلاك الكهرباء فقد تقلص ليصل إلى ٥٠١ فولت فقط فيما ارتفعت السرعة بشك ملحوظ حيث تتراوح السرعة الحالية لوحدات (DDR3)من 800 إلى 1600ميغا هرتز. ومن الجديد بالذاكرة أن وحدات الذاكرة التي تبلّغ سعتها 512ميجا بايت والتي عرضت موخراً على الموقع الإكتروني لشركة (super talent) تعتمد على وحدات سامسونغ التي لم يتم الإعلان عنها بعد. ومن الناحية المادية فإن الذاكرة (DDR3) تشبه الذاكرة (DDR2) فكلا التقنيتان تعتمدان على نظام (Fine-pitch Ball Grid Array) لتجميع الرقائق. كما أن التشابه يشمل التصميم(pin 240) حيث أ، كلتاهما تحتوي على نحو 240 طرف توصيل. ويبدأ الإختلاف من السن الأوسط الذي يقع في أماكن مختلفة في كلا الرقاقتين. وعلى الرغم من أن مجوعة (JEDEC) مازالت في حاجة للانتهاء. من المواصفات الخاصة بالرقاقة (DDR3) إلا أن التوقعات تشير إلى طرح تلك الرقاقة في منتصف العام الحالى وتعمل سوبر تالنت بشكل مكثف على النماذج الخاصة بالرقائق (DDR3) يذكر ان تللك النماذج الجديدة التي تعتمد على وحدات (SAMSUNG)خضعت للتجريب والإختبار من قبل سوبر تالنت عبر عدة مجموعات من أنظمة الإختبار. وبالنسبة للأول اللوحات التي ستدعم رقائق(DDR3)فمن المتوقع ظهورها مع طرح انتل (INTEL)لعائلة منتجاتها من اللوحات الأم (Bearlake) الخاصة بالحاسبات الشخصية. يُذكر أن مجموعات الرقائق الجديدة لشركة (Intel) يمكنها دعم كل من تقنيتي (DDR2)و (DDR3) ولكن لايمكن استخدام كلتاهما معا في نفس الوقت. وقد أعلنت شركة (Intel)عن بداية تجريب اللوحات التي ستتوافق مع رقائق (DDR3) ولكنها لم تؤكد بعد مواعيد طرح تلك للوحات · ومن المتوقع أن تبنى(AMD) استخدام رقائق(DDR3) مع اطلاقها لمنتجاتها الرباعية النواة وقد قامت سوبر تالنت بطرح وحداتها من الذاكرة (DDR3) قبل طرح اللوحات الرئيسية التي تدعمها بوقت طويل. وقد تم طرح الذاكرة في منتصف العام الحالى

صورة للوحة تدعم هذه الذواكر



بعض التفصيل عن هذه الرامات

۱ ـ نطاق ترددي أعلى نتيجةزيادة سعر ساعة

۲ ـ تخفيض الطاقة الكهربائية نتيجة لطراز تكنولوجيا الصنع
٣ ـ إن جهد DDR3 قد خفض ٨, ١ فولت الى ٥, ١ فولت مما يقلل من كمية
الحرارة الناتجة

الفرق بين DDR2وDDR3



الفرق بين الرامات DDR1وDDR2وDDR3

	DUR	DOMES	DOM:
Data Race	205 - ean Miles	400 ~ BOO MITA	800 w : 600 Mb/sx ²
System Sea option	4-ints@hi.ads)	251 4(4 (and s)	24/4(4cm/4)*2
vdd/ydca	2.5Y ± 0.2V	1.6V ± 0.1V	1.50 ± 0.0727
t serace	95T_2	SSTL_18	8571_15
Peckago	55-190-75 ADIC 08	60 Bish for 64,08 64 CGA for >15	78 3GA for 84786 95 3GA for 816
Sauce - ym	B-directional DC9 (Single arroad Cutsuit)	Bi-directions DQS (Single Diff Occos)	Bi-directional OQS (Diffusional Disfault)
Dust Lanoth	HL=A/A,N (2b)ts Feeletch()	4. = 4, 6 (40% Prefetch)	ML = 4, N (8b ta Prefetch)
And lank	Alter des	St2Mis , 4 banks 8Gb : Sbanks	S12Mb/1GL, 8 backs 2/Sb/4Sb/RSb; tod
CLARCOATR	~15/15/15·m	25/25/15 ns	- 12/12/12 ns
leget	Nn	No	Yen
(01	Na	You	You
Oriver Calibration	Mo	OF-Chip Dityer Calibration	Sair relibration with 2Q Pin
Leveling	No	No.	790

هذا العمل المتواضع إهداء إلى والدي العزيز ووالدتي والى جميع المدرسين الذين تابعوني في دراستي الثانوية وما بعدها والى الصديق الغالي عصام الجسري والى أخي عبد الله زعرور مع تحيات عبد الرحمن زعرور سوريا _ حمص موبايل ١٤٧٦١٥٩٠

E_mail:theprince-za08@hotmail.com http://www.3rbsky.co ولمزيد من المعلومات زورنا على الموقع التالي: